



平成 24 年 9 月 28 日

各 位

会 社 名 三 益 半 導 体 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 澤 正 幸
(コード番号 8155 東証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 八 高 達 郎
管 理 本 部 長
(TEL. 027-372-2011)

業績予想及び配当予想に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 7 月 12 日に公表いたしました「平成 24 年 5 月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」において未定としておりました平成 25 年 5 月期の業績予想及び配当予想につきまして、下記のとおりといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 業績予想について

平成 25 年 5 月期第 2 四半期 (累計) 業績予想 (平成 24 年 6 月 1 日～平成 24 年 11 月 30 日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四 半 期 純 利 益	1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	—	—	—	—	—
今 回 発 表 予 想 (B)	22,000	1,100	1,050	600	17.92
増 減 額 (B-A)	—	—	—	—	
増 減 率 (%)	—	—	—	—	
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 24 年 5 月期第 2 四半期)	23,366	1,634	1,504	855	25.54

2. 配当予想について

	年間配当金				
	第 1 四 半 期 末	第 2 四 半 期 末	第 3 四 半 期 末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前 回 予 想	—	—	—	—	—
今 回 発 表 予 想	—	12.00	—	12.00	24.00
当 期 実 績	—		—		
前 期 実 績 (平成 24 年 5 月期)	—	12.00	—	12.00	24.00

3. 公表の理由

平成 25 年 5 月期の業績予想につきましては、半導体デバイスの需要動向などが流動的であったため適切な予想値を算定することが困難であったことから未定としておりましたが、第 2 四半期累計期間については、最近の状況及び業績動向等を踏まえ、予想値を算定しましたので公表いたします。

通期の業績予想につきましては、半導体デバイスの需要動向などが流動的な状況にあり、先行きの事業環境が見通せないことから、現時点においても適切な予想値を算定することが困難であるため、未定とさせていただきます。なお、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。

また、配当金につきましては、当社は業績の向上と株主の皆様への利益配分をともに経営の重要課題と位置付けており、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本方針としております。このような方針のもと、通期業績予想につきましては未公表であります。上記配当予想といたします。

(注) 本資料に記載した業績見通し等は、現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以 上